证券代码：688261　证券简称：东微半导　公告编号：2025-039

苏州东微半导体股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年上半年实际使用募集资金30,403.75万元，2025年上半年收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为524.28万元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金169,099.45万元，募集资金专户余额为37,916.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2025年6月30日，公司实际结余募集资金余额为37,916.65万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	200,655.66
截至期初累计发生额	项目投入	B1	138,695.69
	利息收入净额	B2	6,685.80
	结余募集资金永久补充流动资金	B3	849.64
本期发生额	项目投入	C1	30,403.75
	利息收入净额	C2	524.28
	结余募集资金永久补充流动资金	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	169,099.45
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,210.08
	结余募集资金永久补充流动资金	D3=B3+C3	849.64
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	37,916.65
实际结余募集资金		F	37,916.65
差异		G=E-F	-

注：如有总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-004）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户、2个通知存款账户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	193,792,739.11	募集资金专户、活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801200006972	15,187,098.24	募集资金专户、活期存款
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51549300001103	1,186,660.24	募集资金专户、活期存款
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512906076910302		募集资金专户、活期存款
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000751708		募集资金专户、活期存款
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001011868888888		募集资金专户、活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010076801500003235	127,000,000.00	通知存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010076801000003085	20,000,000.00	通知存款账户
苏州银行股份有限公司工业园区支行	52591700000595	22,000,000.00	结构性存款账户
合 计		379,166,497.59	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年2月22日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

2025年2月20日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用额度最高不超过人民币67,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况如下：

单位:人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	起止日期	预计年化收益率	是否赎回	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	七天通知存款	2,000.00	起息日：2025年2月24日；7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	1.00%	否	2,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	七天通知存款	12,700.00	起息日：2025年6月17日；7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	0.75%	否	12,700.00
苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	2025年第444期定制结构性存款	2,200.00	2025年6月9日-2025年8月11日	1.95%	否	2,200.00
合 计						16,900.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%，主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

截至2025年6月30日，公司累计使用90,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年半年度）

单位：人民币万元

募集资金总额				200,655.66	本年度投入募集资金总额				30,403.75			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				169,099.45			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	否	20,414.58	20,414.58	20,414.58	0	20,639.92	225.34	101.10	2023年8月	不适用	不适用	否
新结构功率器件研发及产业化项目	否	10,770.32	10,770.32	10,770.32	0	10,105.71	-664.61	93.83	2024年7月	不适用	不适用	否
研发工程中心建设项目	否	16,984.20	16,984.20	16,984.20	403.75	1,858.75	-15,125.45	10.94	2025年	不适用	不适用	否
科技与发展储备资金	否	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0	43,893.20	-1,806.80	96.05	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	93,869.10	93,869.10	93,869.10	403.75	76,497.58	-17,371.52	81.49	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	—	90,000.00	90,000.00	30,000.00	90,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	—	2,601.86	2,601.86	0	2,601.86	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	否	—	14,184.70	14,184.70	0	0	-14,184.70	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	106,786.56	106,786.56	30,000.00	92,601.86	-14,184.70	—	—	—	—	—
合 计	—	93,869.10	200,655.66	200,655.66	30,403.75	169,099.45	-31,556.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本专项报告"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况"之"（四）闲置募集资金进行现金管理的情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本专项报告"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况"之"（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：募投项目一"超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目"和募投项目二"新结构功率器件研发及产业化项目"已结项。

注3："本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4："回购股份"行所有数据均包含手续费佣金及证券回购账户的利息收入。

注5：如有总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688261　证券简称：东微半导　公告编号：2025-040

苏州东微半导体股份有限公司关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年第二季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内相关信用及资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

2025年第二季度公司计提各类信用及资产减值准备共计11,214,203.56元，具体情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	资产名称	2025年第二季度计提金额(损失以"-"填列)
信用减值损失	应收账款坏账损失	-1,719,983.55
	应收票据坏账损失	273,469.73
	其他应收款坏账损失	43,238.47
	小计	-1,403,275.35
资产减值损失	存货跌价损失	-9,810,928.21
	小计	-9,810,928.21
合计		-11,214,203.56

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2025年第二季度公司计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失金额共计1,403,275.35元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。经测试，2025年第二季度需计提的资产减值损失金额合计9,810,928.21元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年第二季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失11,214,203.56元，对公司合并报表利润总额影响数为11,214,203.56元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年第二季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码：688261　公司简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	东微半导	688261	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李麟	
电话	+86 512 62668198	
办公地址	江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋	
电子信箱	enquiry@orientalsemi.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,118,370,995.47	3,099,883,346.78	0.60
归属于上市公司股东的净资产	2,922,494,642.09	2,899,743,730.12	0.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	615,831,685.01	419,534,397.10	46.79
利润总额	22,941,321.24	12,309,037.58	86.38
归属于上市公司股东的净利润	27,581,423.21	16,941,427.14	62.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,726,962.26	1,662,716.79	485.00
经营活动产生的现金流量净额	-183,406,220.92	-24,368,076.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.95	0.59	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78
研发投入占营业收入的比例(%)	6.86	9.24	减少2.38个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					11,878		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王鹏飞	境内自然人	12.07	14,795,198	0	0	无	0
苏州工业园区原点创业投资有限公司	国有法人	11.40	13,963,950	0	0	无	0
龚轶	境内自然人	9.97	12,212,651	0	0	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	5.35	6,552,597	0	0	无	0
卢万松	境内自然人	3.54	4,343,357	0	0	无	0
苏州工业园区高惟企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.32	4,071,267	0	0	无	0
苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.11	2,591,389	0	0	无	0
王绍泽	境内自然人	1.63	2,002,000	0	0	无	0
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.59	1,951,011	0	0	无	0
苏州从容私募基金管理合伙企业(有限合伙)－苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.55	1,905,190	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王鹏飞与龚轶系公司共同实际控制人，苏州工业园区高惟企业管理合伙企业(有限合伙)系王鹏飞控制的企业；苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙)系龚轶控制的企业； 2、中新苏州工业园区创业投资有限公司及苏州工业园区原点创业投资有限公司同为苏州工业园区经济发展有限公司控制的企业，苏州工业园区原点创业投资有限公司系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司； 3、卢万松、王绍泽系公司共同实际控制人王鹏飞和龚轶的一致行动人； 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688261　证券简称：东微半导　公告编号：2025-041

苏州东微半导体股份有限公司关于参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议内容：2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会

●会议召开时间：2025年9月8日(星期一)下午：15:00-17:00?

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)?

●会议召开方式：上证路演中心网络互动?

●投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日发布了公司2025年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2025年9月8日(星期一)下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?

三、参加人员

董事长、总经理龚轶先生；财务负责人谢长勇先生；董事、董事会秘书李麟女士；独立董事黄清华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年9月8日（星期一）下午15:00-17:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0512-62668198

邮箱：enquiry@orientalsemi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025年8月29日

公司代码：688347　公司简称：华虹公司

华虹半导体有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用　□不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	华虹公司	688347	不适用
港股	香港联交所主板	华虹半导体	01347	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)	钱蕾
电话	86-21-38829909	86-21-38829909
办公地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	86,285,164,062.48	87,935,231,475.57	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	43,784,775,744.34	43,602,332,245.07	0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,017,656,907.53	6,732,158,761.10	19.09
利润总额	-594,777,334.01	-567,505,333.85	4.81
归属于上市公司股东的净利润	74,315,361.59	264,916,278.85	-71.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,391,752.37	233,848,615.27	-76.31
经营活动产生的现金流量净额	1,620,396,625.79	1,328,909,045.07	21.93
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.61	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.15	-73.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.15	-73.33
研发投入占营业收入的比例(%)	11.99	11.50	增加0.49个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					37,424	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
香港中央结算(代理人)有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	42.75	738,355,823	0	0	未知
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	境外法人	20.13	347,605,650	0	0	无
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	境外法人	9.30	160,545,541	0	0	无
鑫芯（香港）投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	境外法人	4.11	71,031,601	0	0	无
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	境内非国有法人	2.80	48,334,249	0	0	无
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	0.62	10,697,339	0	0	无
中信证券股份有限公司	国有法人	0.58	9,999,629	0	0	无
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	9,686,637	0	0	无
海通创新证券投资有限公司	国有法人	0.47	8,155,000	8,155,000	8,155,000	无
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	0.47	8,155,000	8,155,000	8,155,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.华虹国际、华虹集团、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司均受上海市国资委控制。 2.鑫芯(香港)投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过鑫鑫(上海)投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进行管理。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

A股代码：688347　A股简称：华虹公司　公告编号：2025-021

港股代码：01347　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司 关于聘任高级管理人员及核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 华虹半导体有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年8月28日作出决议，委任陈一敏女士担任公司的执行副总裁，同时，公司认定陈广龙先生为公司的核心技术人员，并不再将Guangping Hua(华光平)先生(以下简称"华先生")认定为公司的核心技术人员。

● 上述人员调整不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响。

一、委任高级管理人员及核心技术人员的情况

经公司董事会于2025年8月28日作出决议，同意委任陈一敏女士担任公司的执行副总裁；同时，公司认定陈广龙先生为公司的核心技术人员。陈一敏女士与陈广龙先生的简历如下：

陈一敏女士，43岁，现任公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司(以下简称"上海华虹宏力")、华虹半导体(无锡)有限公司(以下简称"华虹无锡")及华虹半导体制造(无锡)有限公司(以下简称"华虹制造")执行副总裁、上海华虹宏力党委副书记，协管人力资源工作。陈一敏女士于二零二二年一月加入本公司，拥有近20年半导体行业工作经验，历任上海华虹宏力党委副书记、纪委书记，华虹无锡党委副书记。此前，陈一敏女士曾在华虹国际管理(上海)有限公司、上海华虹(集团)有限公司(以下简称"华虹集团")等公司任职。陈一敏女士毕业于上海外国语大学，获新闻学专业文学学士学位。

截至本公告披露之日，陈一敏女士未直接持有公司A股及港股股份。陈一敏女士目前担任华虹集团职工监事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

陈广龙先生，44岁，任上海华虹宏力、华虹无锡及华虹制造高级副总裁，分管技术研发相关工作。陈广龙先生于二零一八年九月加入本公司，拥有逾20年半导体行业工作经验，历任华虹无锡工艺整合部部长、集成三部总监、副总裁兼七厂常务副厂长。此前，陈广龙先生曾在上海新进半导体制造有限公司、上海华虹NEC电子有限公司、上海华力微电子有限公司任职。陈广龙先生毕业于电子科技大学，获电子科学与技术专业工学学士学位。

截至本公告披露之日，陈广龙先生未直接持有公司A股及港股股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、原核心技术人员变动的具体情况

公司董事会于2025年8月28日作出决议，同意Guangping Hua(华光平)先生将不再作为公司的核心技术人员，仍任公司执行副总裁。

（一）华先生的基本情况

华先生，57岁，新加坡籍。现任本公司执行副总裁。华先生拥有近30年半导体行业经验，此前先后效力于清华大学微电子所、新加坡特许半导体制造有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、上海华虹NEC电